第一图书网, tushu007.com

<<微电子技术概论>>

图书基本信息

书名：<<微电子技术概论>>

13位ISBN编号：9787118043730

10位ISBN编号：7118043737

出版时间：2006-3

出版时间：国防工业出版社

作者：常青

页数：183

字数：271000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书从微电子技术的发展历程与发展特点入手，系统地介绍了作为信息社会基石的微电子技术的基本概念与关键技术。
内容涵盖集成器件物理基础、集成电路制造工艺、集成电路设计方法、IC-CAD技术和集成电路的测试与封装等多个方面。
　本书内容系统，选材先进。
既有对微电子器件与工艺的一般介绍，又有对微电子技术的深入论述。
本书可作为非微电子专业电子与电气类本科生的教材与参考书，也可以作为各类高级技术和管理人士学习微电子技术的入门参考书。

<<微电子技术概论>>

书籍目录

第1章 绪论 1.1 微电子技术的发展历程 1.2 集成电路的分类 1.3 微电子技术的发展特点与发展趋势 参考文献第2章 集成电路中的半导体器件 2.1 半导体的特性 2.2 PN结和晶体二极管 2.3 双极型晶体管 2.4 MOS场效应晶体管 2.5 集成电路中的无源元件 参考文献第3章 集成电路制造技术 3.1 集成电路的制造过程 3.2 硅平面工艺的基础工艺 3.3 集成电路的制造工艺 参考文献第4章 IC基本单元电路与版图设计 4.1 数字IC的基本电路 4.2 CMOS基本逻辑电路 4.3 CMOS版图设计 4.4 等比例缩小规则 参考文献第5章 VLSI设计与CAD 5.1 VLSI设计流程 5.2 ASIC设计方法 5.3 IC-CAD技术 5.4 硬件描述语言 5.5 逻辑综合 5.6 逻辑模拟与电路模拟 参考文献第6章 集成电路的测试与封装 6.1 集成电路测试的一般概念 6.2 故障模型与向量的设计 6.3 可测性设计 6.4 集成电路的封装 6.5 MCM——未来集成电路封装的重要发展方向 6.6 集成电路封装的选择参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com